

2023年1月  
三菱製紙株式会社

**「第37回 ネプコンジャパン エレクトロニクス開発・実装展」出展のお知らせ**

三菱製紙株式会社は、2023年1月25日(水)～1月27日(金)、東京ビッグサイトにて開催される「第37回 ネプコンジャパン エレクトロニクス開発・実装展」に出展いたします。

本展示会では、電子工業材料市場向けに開発した各種機能性ドライフィルムレジスト、レジスト処理プロセス関連製品の出展を予定しておりますので、是非当社ブースにお立ち寄りください。

**【開催概要】**

- 名称 : 第37回 ネプコンジャパン エレクトロニクス開発・実装展  
電子部品・材料 EXPO
- 会期 : 2023年1月25日(水)～1月27日(金)
- 時間 : 10:00～17:00
- 会場 : 東京ビッグサイト
- URL : <http://www.nepconjapan.jp/>  
※同展示会は日本最大級のエレクトロニクス製造・実装技術展です。  
無料招待券を上記URLよりダウンロードできます。

**【当社出展概要】**

- 出展場所 : 東展示棟 第3ホール内、小間番号「20-38」
- 出展内容 : 溶解剥離性ドライフィルムレジスト「MS9000 series」「MSP4000 series」  
高耐久性サンドブラスト用ドライフィルムレジスト「MS7000 series」  
高解像/高密着サンドブラスト用ドライフィルムレジスト「MSAD series」  
高耐薬品性ドライフィルムレジスト「KN30 series」  
ソルダーレジスト薄膜化処理システム  
ポジ型ドライフィルムレジスト(参考出品)  
厚銅エッチング用ドライフィルムレジスト(参考出品)

**【本件に関するお問い合わせ先】**

機能商品事業部 事業開発部 電子工業材料グループ  
E-mail: [denzai@mpm.co.jp](mailto:denzai@mpm.co.jp)  
TEL: 03-5600-1476

以上